



RE900-01

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au y una máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para TSOP I 28, 40, 48, 60 (0,40 mm)
- Diámetro de agujeros 1,00 mm
- Bajo demanda se ponen a disposición gratuitamente los datos Gerber para la fabricación de la impresión de pasta de soldar
- Tamaño 29,29 x 43,64 mm

Módulo-No.	Typ	Pitch	Pin	Tamaño (mm)
RE900-01	TSOP I	0,400 mm	28, 40, 48, 60	12,00 x 18,00